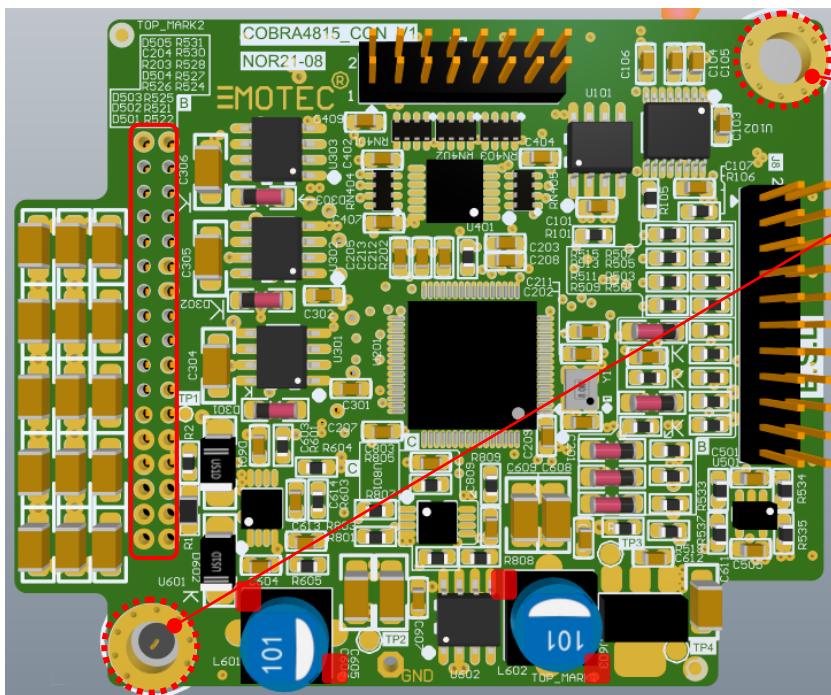


PCB 焊接 工艺要求	产品名称 直流伺服	产品型号 COBRA4815_CON_V1	工序 焊接	文件编号 QM0332021082702	版本 V1	页数 1/1	制订时间 20210827
----------------	--------------	--------------------------	----------	-------------------------	----------	-----------	------------------

COBRA4815\_CON\_V1 控制板焊接要求

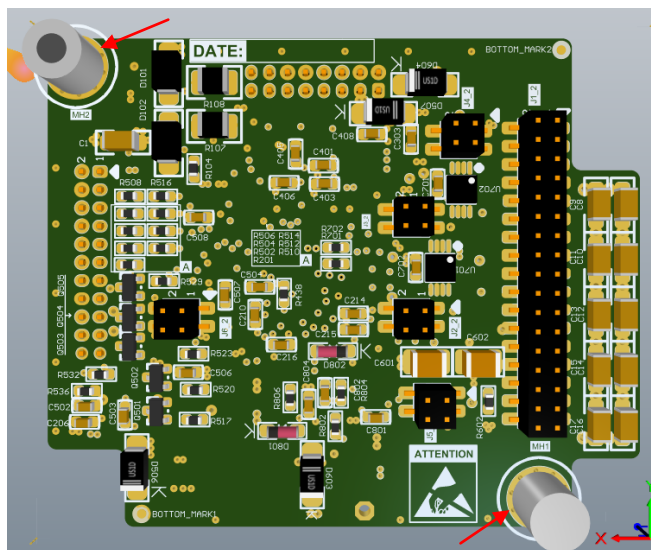
1. 顶层



红色虚线框内焊盘孔，底层焊接贴片螺母的焊锡，漏到顶层板面，但不能高出顶层面

- 1) 框内焊盘孔，测试点及 MARK 点不接受沾锡
- 2) 框内焊盘孔，在底层焊接贴片螺母的锡漏到顶层，该锡面不能高过图示的顶层板面
- 3) 红色半透明色块区域为点胶位置分布图，点固定胶（黑色 704 固定胶），点胶厚度为 1.5mm;

2. 底层



正确（圆锥面焊锡）



少锡

MH1, MH2 贴片螺母，要求落到底焊接，保证焊接后螺母垂直于 PCB，同时焊盘圆周上的过孔注满锡，但锡面不能高过顶层板面；此外，注意贴片螺母的焊接锡量，要在其圆周上形成锥面（见上图）；

3. 所有排针排母焊接，需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
4. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	